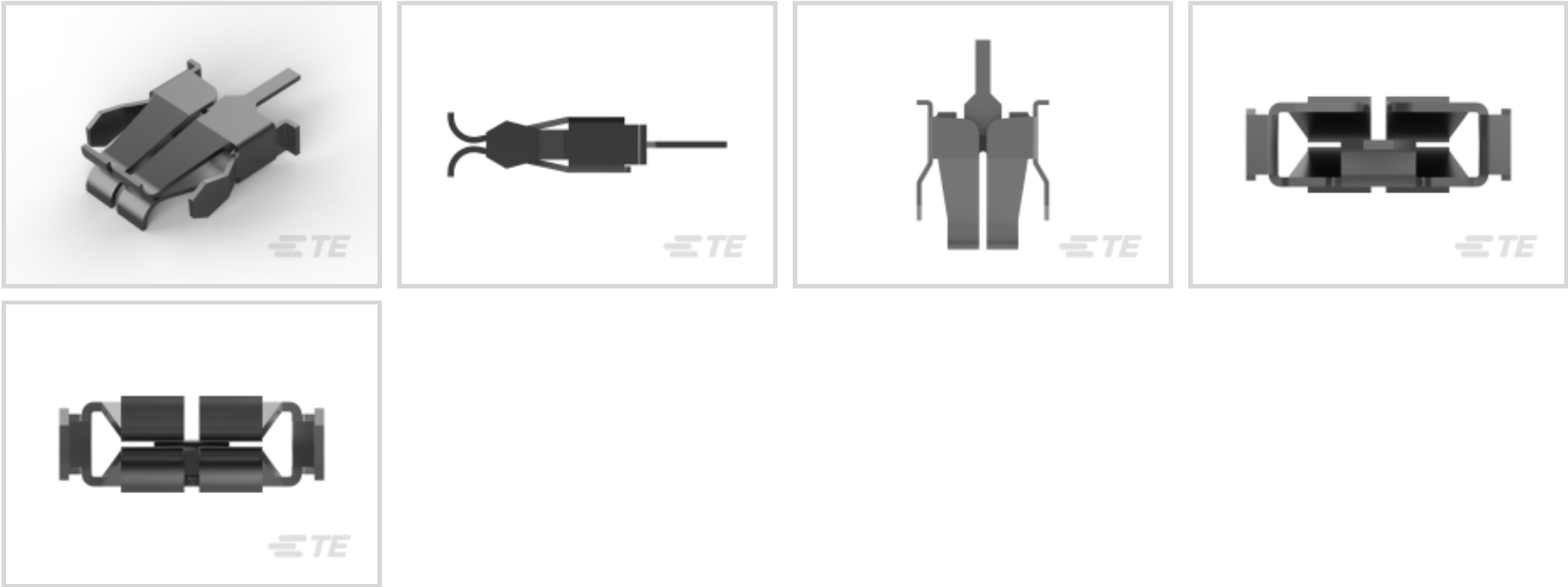




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 的外形高度: 9.6 mm [.382 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

端子电镀材料: 锡

封装方法: Carton

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 – 4 µm[78.74 – 157.48 µin]
端子底板材料厚度	1 – 2 µm[39.37 – 78.74 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	2 – 4 µm[78.74 – 157.48 µin]
PCB 端子类型	母端
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

板下延伸	4 mm[.157 in]
PCB 的外形高度	9.6 mm[.382 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准



与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 |

客户还购买了



文档



产品图纸

PCB SOCKET TPBR LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_925681-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925681-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925681-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Receptacle, Spade, PCB

英文版本